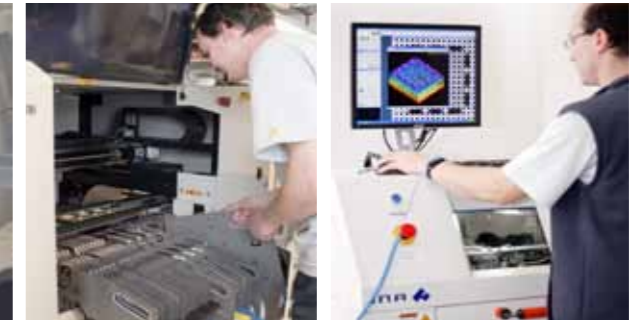




LT ELEKTRONIK wurde im Jahre 1997 gegründet und etablierte sich im Markt als ein Entwicklungsdienstleister für den professionellen Anwendungsbereich.

Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungspaket im kompletten Spektrum des Electronic Manufacturing Services (EMS). Dazu gehören innovative Hard- und Software-Lösungen für alle Bereiche und Anpassungsentwicklungen für jeden Einsatz.



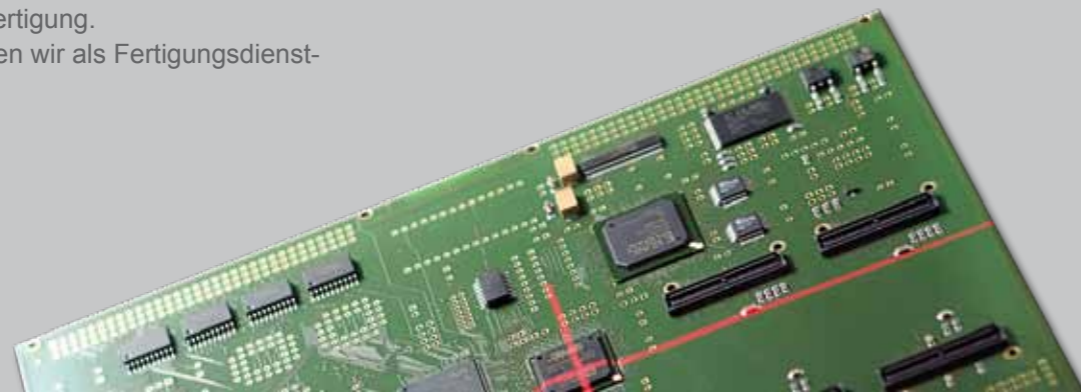
Das Leistungsspektrum umfasst:

1. Entwicklung kompletter elektronischer Baugruppen nach Kundenvorgaben/Pflichtenheft
 - Schaltungsentwurf
 - Layout
 - EMV-Nachweis
 - Bau von Prototypen
 - Prüfung
2. Herstellung von Klein-, Mittel- und Großserien
3. Materialeinkauf unter Nutzung internationaler Bezugsquellen
4. Bau von Prüfausrüstungen für die Funktionsprüfung
5. After-Sales-Service

Immer die beste Lösung:

Klein-, Mittel- und Großserien

Die neu entwickelten Baugruppen können wir in Klein-, Mittel- und Großserien produzieren. Wir führen kundenspezifische Anforderungen lösungsorientiert bis zur kostenoptimierten Serienfertigung. In diesem Segment arbeiten wir als Fertigungsdienstleister für Unternehmen.



Einkauf:

Materialeinkauf bei internationalen Lieferanten

Beim Materialeinkauf nutzt LT ELEKTRONIK langjährige und stabile internationale Lieferantenkontakte für die termingerechte Beschaffung von qualitativ hochwertigen Komponenten zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Alles im Blick:

Baugruppenprüfung

Die bestückten Leiterplatten werden mit AOI-Systemen automatisiert auf Vollständigkeit und fehlerfreie Montage geprüft. Computergestützte Prüftechnik garantiert eine umfassende Kontrolle der Baugruppen bei gleichzeitiger Minimierung von subjektiven Einflüssen. Eine Lötstelleninspektion an Bauteilen wie z.B. FBGAs oder BGAs ist mittels x-ray AOI möglich.

Fertigungsverfahren:

Raumsparende Mikrosystemlösungen

Die Bestückung der Baugruppen ist in SMD-, THT- und COB-Technologie möglich. Wir verarbeiten SMD-Komponenten von Size 0201 bis zu CSP, OFP, BGA, µBGA und Flip Chip.

Mit modernsten-Lötverfahren wie Selektivlöten, Dampfphasenlöten, Wellenlöten und Reflowlöten sichern wir eine schonende Verarbeitung der Komponenten und eine hohe Verbindungsqualität zur Leiterplatte.

Chip on board Technologie

Mit unserer Chip-on-board-Technologie schaffen wir für unsere Kunden raumsparende Mikrosystemlösungen. Die Produktion erfolgt mit hochpräziser Fertigungsausrüstung in folgenden Schritten:

DIE-BONDEN: Chips aufsetzen und ausrichten

- Dispensen oder Stempeln des Klebers
- Verarbeitung aus Verpackung blue tape, gelpack und wafflepack
- Wafer mapping möglich

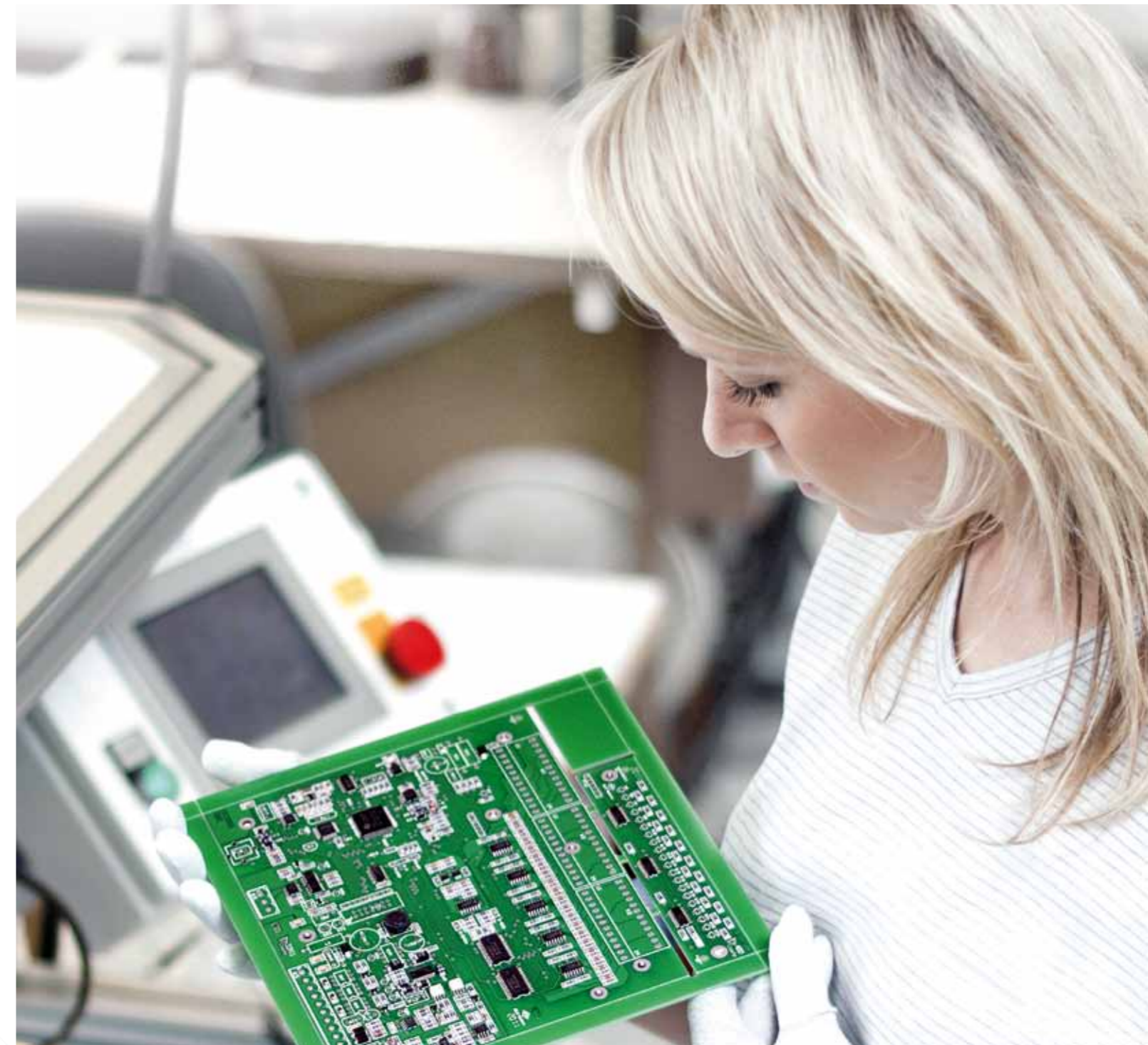
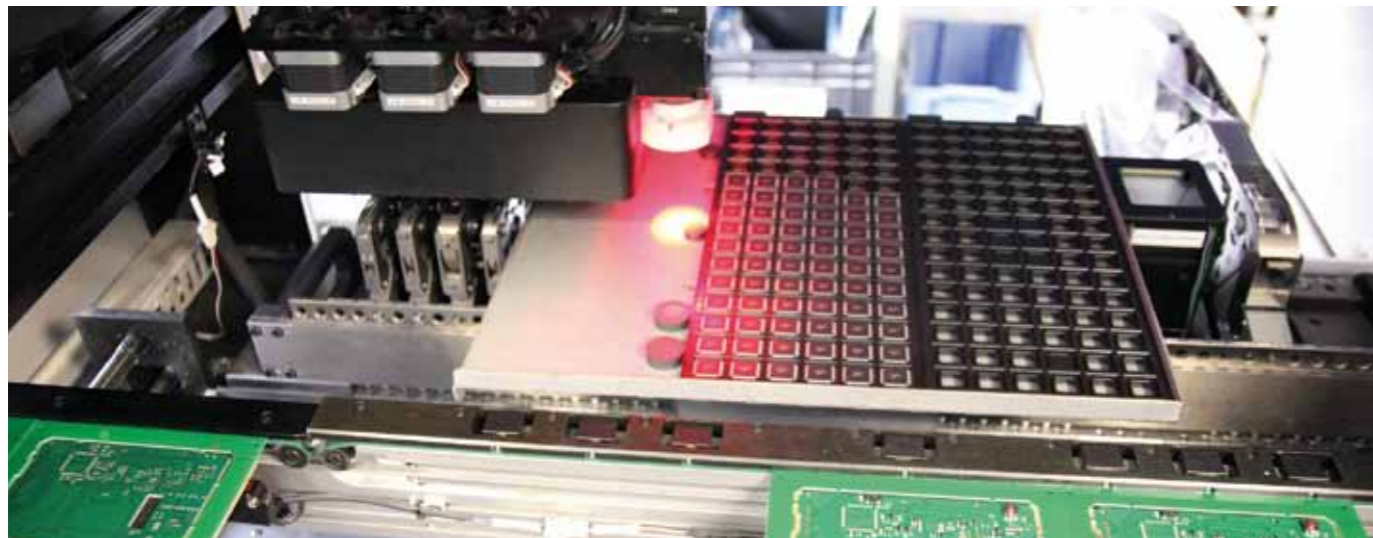
DRAHT-BONDEN: Chip kontaktieren

- Ball/Wedge- oder Wedge/Wedge-Verfahren
- Bonden von Gold- oder Aluminiumdrähten mit einem Drahtdurchmesser von 17 bis 75 Mikrometer
- Wafer mapping möglich

PASSIVIERUNG: Dauerhaft festigen

- Ausführung in verschiedenen Geometrien und glob-top-Formen möglich
- Einsatz verschiedener Klebersorten wärme- und UV-aushärtend





Kundenorientierung hat höchste Priorität:

After - Sales - Service

Ein guter Kundendienst während der Fertigung und nach dem Kauf gehört bei uns zum guten Ton. Persönliche Betreuung und Einbeziehung der Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden sind unsere Leitlinien. Daran dürfen Sie uns messen.

Qualität und Umwelt

Unsere Kunden schätzen die hohe Qualität der Erzeugnisse und die Liefertreue. Großen Wert legen wir schon bei Beginn der Entwicklung auf die Nachhaltigkeit der Produkte. Das Qualitätssicherungssystem der Fertigungsstätte ist nach ISO 9001:2009 zertifiziert. Planmäßige Schulungen sichern ein permanent hohes Qualitätsbewusstsein bei unseren Mitarbeitern. Die Fertigung erfolgt unter Beachtung der Umweltverordnungen. Alle Produkte, die wir ausliefern, sind RoHS-konform.

LT Elektronik Gera GmbH
Gewerbepark Keplerstraße 26
D-07549 Gera

Tel. +49 365 77320-0
Fax +49 365 77320-20

info@lt-elektronik.de
www.lt-elektronik.de

innovativ - flexibel - zuverlässig